



ADVANTEST[®]

2021年度（2022年3月期） 決算説明会

2022年4月27日
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ご注意

会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。



```
...mirror_object = ...  
operation == "MIRROR_X":  
    mirror_mod.use_x = True  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = False  
    operation == "MIRROR_Y":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = True  
    mirror_mod.use_z = False  
    operation == "MIRROR_Z":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = True  
  
selection at the end -add  
obj.select= 1  
obj.select= 1  
context.scene.objects.active  
obj.select= 0  
obj.select= 0
```

2021年度決算報告

取締役 兼 経営執行役員
CFO & CCO (Chief Financial Officer & Chief Compliance Officer)
管理本部長 藤田 敦司

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

FY21業績ハイライト

- FY21通期で過去最高の受注高、売上高、営業利益、当期利益を達成
- FY21の受注高は、半導体需要の拡大および高性能化を背景に7,000億円台に
- 高付加価値テストの売上比率の増加により、売上総利益率が改善
- ROE 30.4%

○ 2021年度業績ハイライト

- 2021年度は、受注高、売上高、営業利益、当期利益ともに、それぞれ過去最高となる実績を収めることができました。当社ビジネスを継続して支えていただいているお取引先各社をはじめ、従業員、すべてのステークホルダーの皆様に深謝いたします。
- 社会のデジタル化進展から、データセンター投資の拡大、5Gスマートフォンの高性能化、微細化をはじめとする半導体の高性能化を背景に、積極的なテスト投資がSoC半導体メーカー中心に年度を通し継続して行われました。
- 半導体需要の長期的な拡大および持続的な高性能化の流れが継続しています。一方、半導体などの広範囲な部材不足に伴い当社製品は長納期化しました。このような状況を背景に、顧客の発注タイミングが従来より早期化しました。その結果、受注高は前年度比2倍の7,000億円に到達しました。
- また売上においては、高機能半導体に向けた付加価値の高いテスト比率が増加したことにより、売上総利益率も前年度より改善いたしました。
- ROEについては、利益拡大、株主還元強化と資本効率向上への取り組みにより30.4%となりました。

FY21業績概要

	FY20		FY21		
	実績	1月時点 予想	実績	前年度比	
				増減額	増減率
受注高	3,306	6,500	7,003	+3,697	2.1倍
売上高	3,128	4,100	4,169	+1,041	+33.3%
営業利益	707	1,150	1,147	+440	+62.2%
営業利益率	22.6%	28.0%	27.5%	+4.9pts	
税引前利益	696	1,150	1,163	+467	+67.1%
当期利益	698	863	873	+175	+25.1%
当期利益率	22.3%	21.0%	20.9%	-1.4pts	
受注残	1,088	3,512	3,947	+2,858	3.6倍
為替レート	1米ドル	106円	112円	112円	6円 円安
	1ユーロ	123円	131円	130円	7円 円安
1株当たり配当額（年間）	118円	-	120円*1	+2円	
自己株式取得額	131	-	700	+569	
総還元性向*2	52%	-	107%	+55pts	

* 1: FY21の期末配当は2022年5月20日開催の取締役会において正式決定する予定です

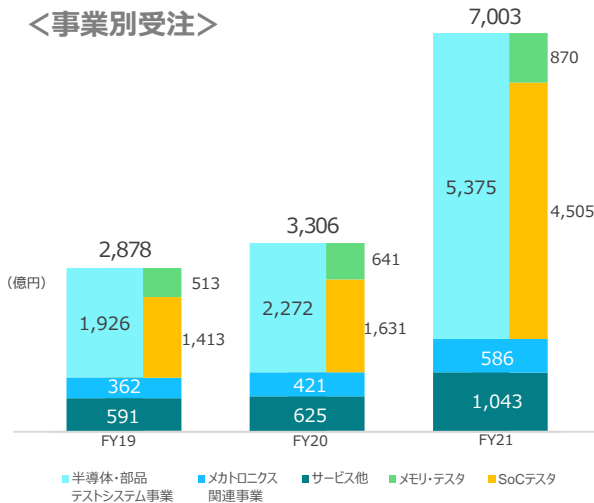
* 2: 総還元性向 = (配当総額 + 自己株式取得額) ÷ 当期利益

○ 2021年度業績概要

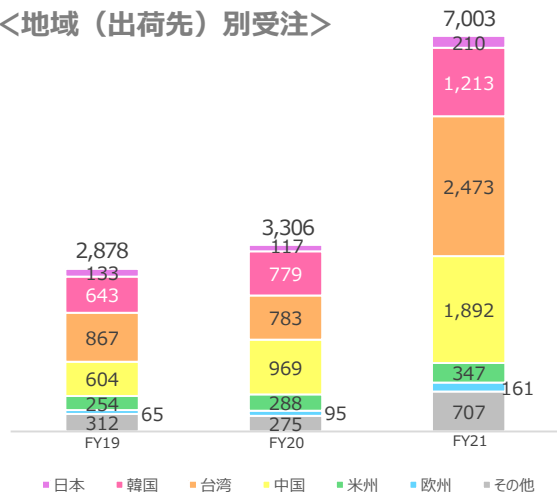
- 2021年度の業績はスライドの通りとなります。
 - 受注高 7,003億円
 - 売上高 4,169億円
 - 営業利益 1,147億円
 - 当期利益 873億円
- 受注の大幅な伸びにより、受注残は3,947億円となりました。
- なお当期利益における前期比増加率が緩やかであるのは、前年度に繰越欠損金使用と、繰延税金資産計上があったために、税負担が小さかったことによります。
- 期末配当予想は70円、中間配当実績 50円と合わせ、年間配当予想は 120円とします。自己株式取得と配当を合わせた総還元性向は 107%となります。

FY21受注実績 年度比較

<事業別受注>



<地域（出荷先）別受注>



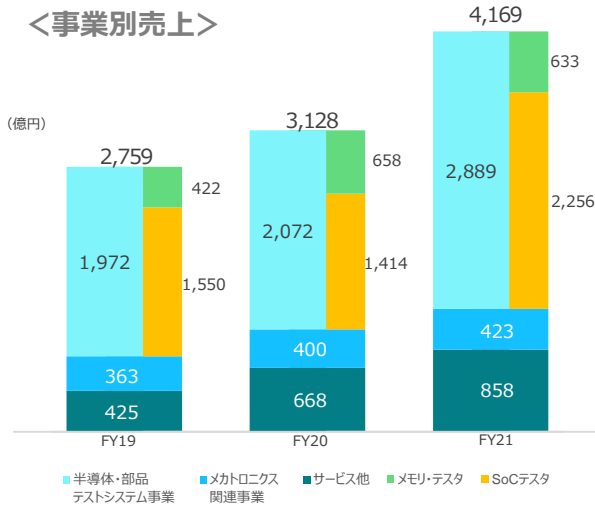
*合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

○ 2021年度の受注高実績

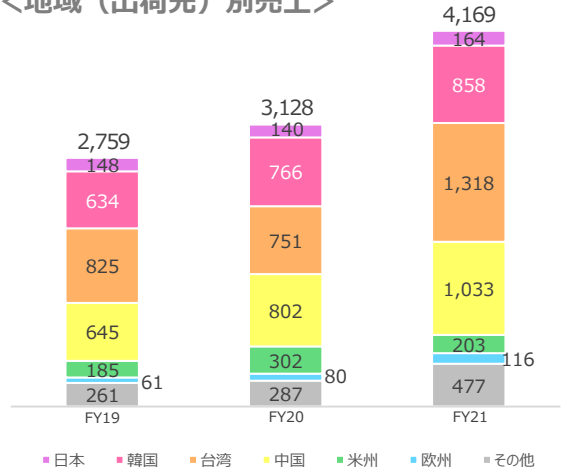
- ・ 事業別、地域別の年度受注実績はご覧の通りです。
- ・ 2021年度は全事業において前年度より受注は増加しました。
- ・ アプリケーション・プロセッサ（APU）やハイ・パフォーマンス・コンピューティング（HPC）デバイスなどハイエンドSoC半導体において一段の微細化や性能向上が進展したこと、また半導体不足に対する供給能力拡大投資が推進されていることを背景に、SoCテストの受注高が大きく伸長しました。
- ・ 地域別では、台湾、中国、韓国を中心に全地域で受注が伸長しました。特に台湾が最大の受注の仕向け地となっています。

FY21売上実績 年度比較

<事業別売上>



<地域（出荷先）別売上>



*合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

○ 2021年度の売上高実績

- こちらは年度売上実績です。
- 半導体不足の影響により供給リードタイムの長期化を余儀なくされましたが、ハイエンドSoC向けを中心に、SoCテストで売上高を伸ばしました。
- 地域別では、受注と同様に台湾が最大仕向地となりました。

四半期業績推移

(億円)

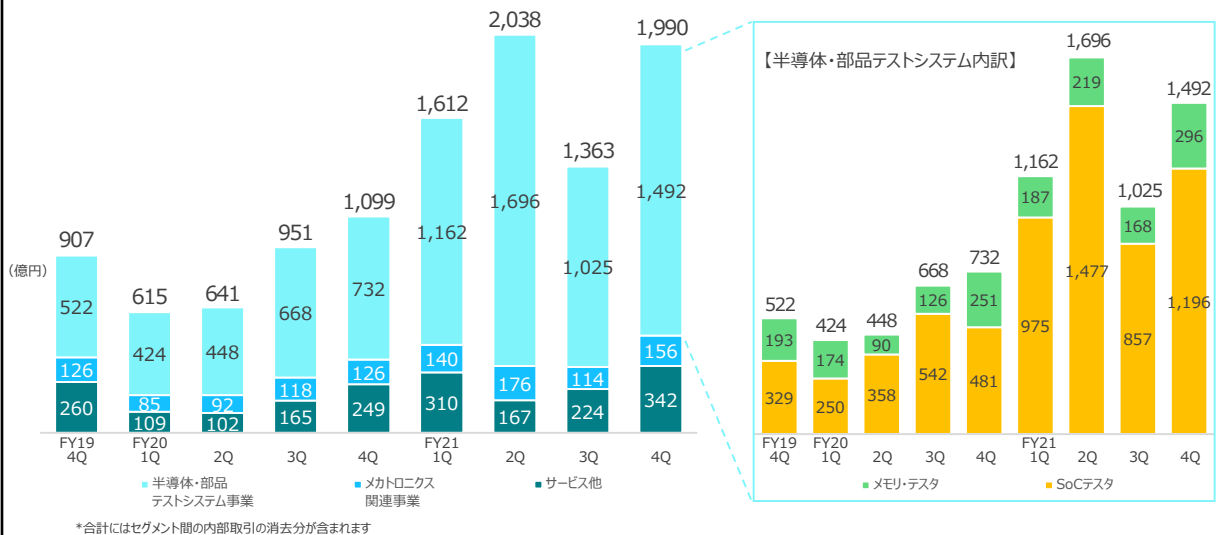
	FY20				FY21				前期比		前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	増減額	増減率	増減額	増減率
	受注高	615	641	951	1,099	1,612	2,038	1,363	1,990	+627	+46.0%	+890
売上高	667	774	781	906	971	909	1,121	1,168	+48	+4.2%	+262	+28.9%
売上総利益	380	416	402	485	547	501	648	663	+15	+2.2%	+178	+36.8%
売上総利益率	56.9%	53.9%	51.5%	53.5%	56.4%	55.0%	57.9%	56.7%	-1.2pts		+3.2pts	
営業利益	135	174	153	245	261	214	335	337	+1	+0.4%	+91	+37.2%
営業利益率	20.2%	22.6%	19.5%	27.1%	26.9%	23.5%	29.9%	28.8%	-1.1pts		+1.7pts	
税引前四半期利益	129	164	139	264	257	216	340	350	+9	+2.7%	+86	+32.4%
四半期利益	106	139	120	333	193	159	257	264	+8	+3.0%	-69	-20.6%
四半期利益率	15.8%	18.0%	15.4%	36.7%	19.9%	17.5%	22.9%	22.6%	-0.3pts		-14.1pts	
受注残*	857	725	895	1,088	1,729	2,858	3,125	3,947	+822	+26.3%	+2,858	3.6倍
為替レート	1米ドル	108円	107円	105円	104円	109円	110円	112円	115円	3円 円安		11円 円安
	1ユーロ	118円	123円	124円	127円	131円	130円	130円	130円	-		3円 円安

*FY21の3Qの受注残には、R&D Altanova社のM&Aに伴う移行注残24億円が含まれます

○ 2021年度第4四半期の業績概要

- 2021年度の4Qは、四半期開示を開始して以来、売上高、営業利益、税引前四半期利益については過去最高となりました。
- 各項目の詳細は次ページ以降でご説明いたします。

四半期受注高 事業セグメント別



○ 2021年度第4四半期の受注高

- 半導体などの不足が広範囲なサプライチェーンに影響を及ぼす中、当社製品の長納期化も継続しています。顧客も長期スパンでの計画に基づきテストを発注する割合が従来よりも増加しました。

○ 半導体・部品テストシステム事業

- 前期比 45.5%増 1,492億円
- SoCテストは、前期比339億円増の1,196億円でした。HPC関連を中心に先端プロセスを採用する品種数の増加により、受注高が大幅に伸長しました。
- メモリ・テストは、前期比128億円増の296億円でした。ウエハテスト中心に、特にDRAM向けに受注が力強く伸びました。

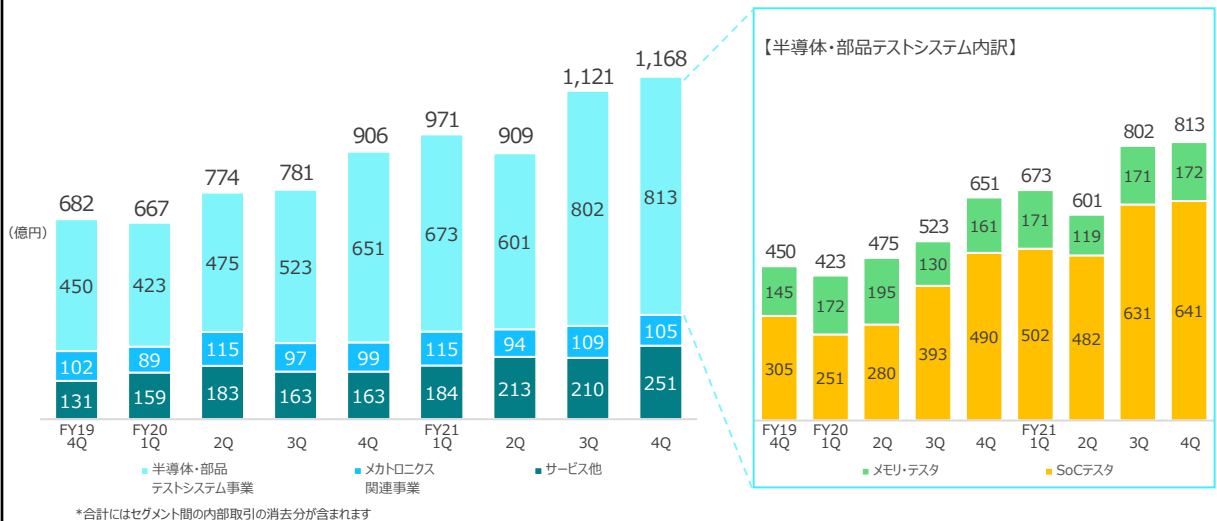
○ メカトロニクス関連事業

- 前期比37.5%増 156億円
- デバイス・インタフェースやテスト・ハンドラなどはテストビジネスとの連動性が高いため、このセグメントの受注も増加しました。

○ サービス他

- 前期比 52.3%増 342億円
- システムレベルテスト（SLT）関連の受注が大幅に伸びたことに加え、保守の年間契約更新が季節的要因もあり増加しました。

四半期売上高 事業セグメント別



○ 2021年度第4四半期の売上高

- 部材不足は継続中ではありますが、部材調達への取り組みの結果、計画を上回る売上を計上することができました。

○ 半導体・部品テストシステム事業

- 前期比横ばい 813億円
- 内訳としては、SoCテストが641億円、メモリ・テストは172億円です。

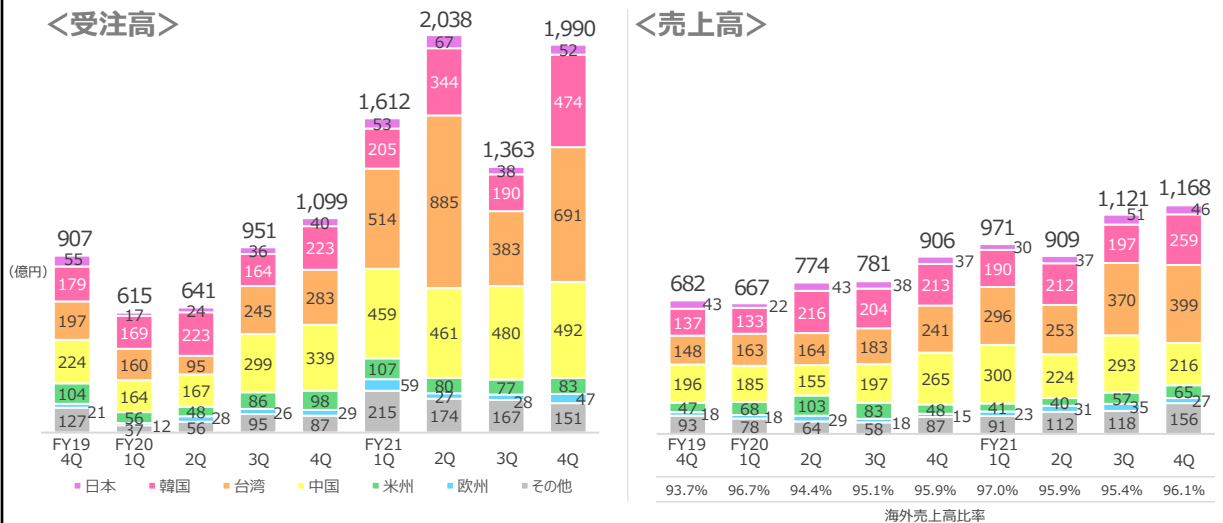
○ メカトロニクス関連事業

- 前期比 微減 105億円

○ サービス他

- 前期比 20.1%増 251億円
- SLT関連の売上高が増加しました。

四半期受注高/売上高 地域(出荷先)別



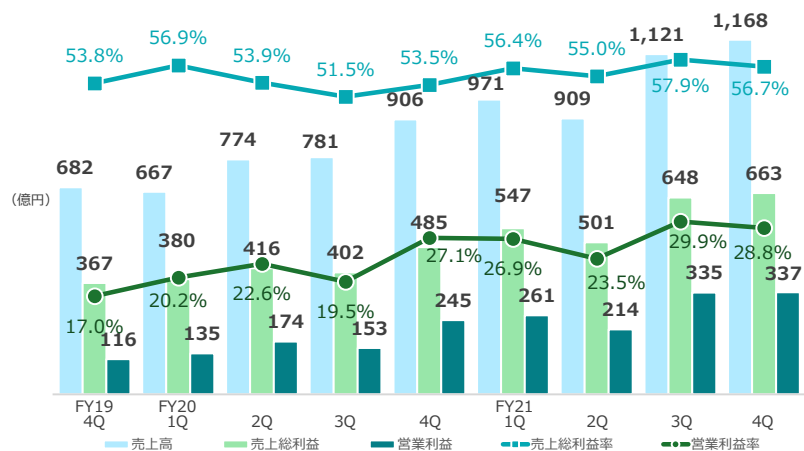
○ 2021年度第4四半期の地域別受注高

- 台湾
HPC関連を中心とした、先端プロセスを採用するSoCテスト中心に受注が大幅に増加しました。
- 韓国
メモリテストの受注の伸びに加え、スマートフォン関連のSoCテストの受注が伸びました。

○ 2021年度第4四半期の地域別売上高

- 地域ごとに変動はありますが、全体としては売上拡大基調にあります。

売上高/売上総利益/営業利益



(億円)

	FY20	FY21
売上高	3,128	4,169
売上総利益	1,683	2,359
売上総利益率	53.8%	56.6%
販管費等	976	1,212
営業利益	707	1,147
営業利益率	22.6%	27.5%

○ 2021年度第4四半期の営業利益

- 売上総利益率 56.7%
- 3Qと比較すると、若干下がりましたが、高水準な売上総利益率を保ちました。
- 販管費等（その他収益・費用を合算） 326億円
- 営業利益 337億円
- 営業利益率 28.8%

○ 2021年度通期の営業利益

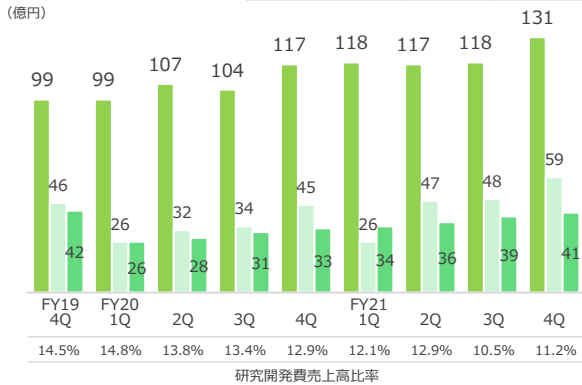
- 通期営業利益 前年度比 62.2%増 1,147億円
- スマートフォンやデータセンター関連のハイエンドSoC半導体向けテストの売上が伸長したことで、製品ミックスが改善し、売上総利益率が上昇しました。
- 営業利益も大幅に増加しました。

投資等/キャッシュ・フロー

<投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費

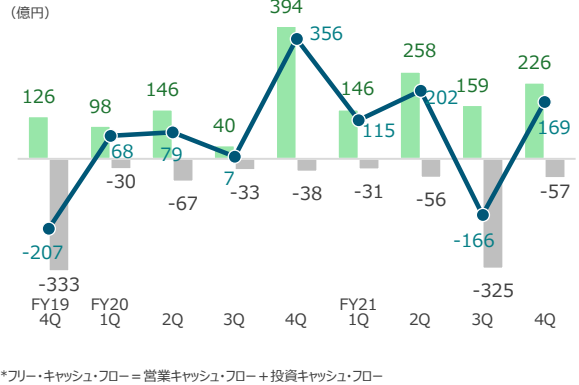
	FY20	FY21
研究開発費	427	484
売上高比率	13.6%	11.6%
設備投資	137	180
減価償却費	118	150



<キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー

	FY20	FY21
営業キャッシュ・フロー	678	789
投資キャッシュ・フロー	-168	-469
フリー・キャッシュ・フロー*	510	320



○ 2021年度第4四半期の研究開発費等

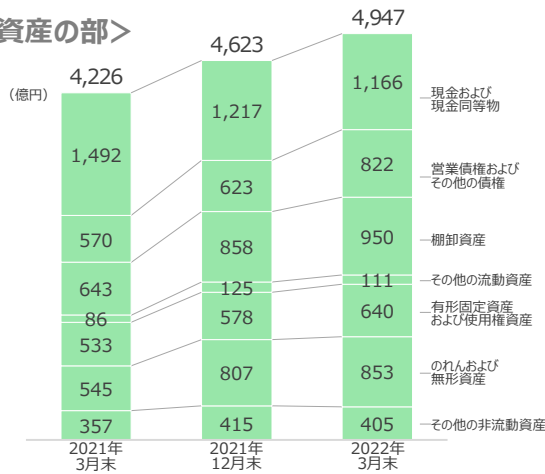
- 研究開発費 131億円
- 研究開発費売上高比率 11.2%
- 設備投資 59億円
2Qより着手した米国製造拠点の拡張投資を4Qも実行しました。
- 減価償却費 41億円

○ 2021年度第4四半期のキャッシュ・フローの状況

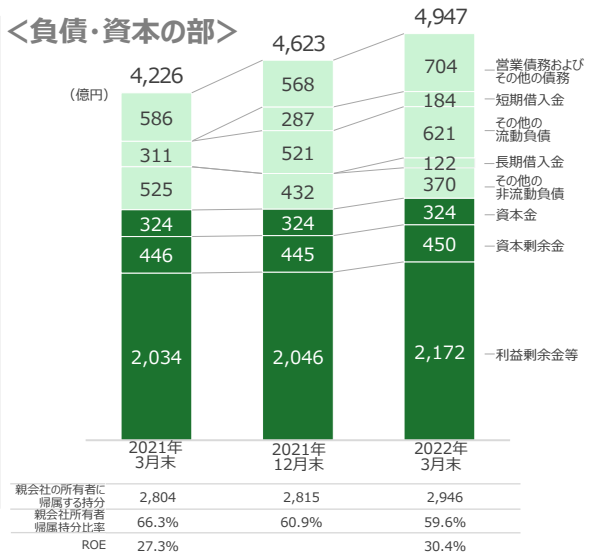
- フリー・キャッシュ・フロー 169億円

連結財政状態

<資産の部>



<負債・資本の部>



○ 2022年3月末時点のバランス・シート

- 総資産 4,947億円
- 現金および現金同等物 1,166億円
- のれんおよび無形資産 853億円
- 親会社の所有者に帰属する持分 2,946億円
- 親会社所有者帰属持分比率 59.6%
- 2021年度は総額700億円、総数717万株の自己株式の取得を実施する一方、事業規模と業容の拡大を図る中で約300億円の必要資金を外部から調達しました。今後も成長投資と資本効率性のバランスを考え、BSマネジメントに取り組んでいきます。



第2期中期経営計画の進捗と2022年度事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長（CEO）

吉田 芳明

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

ADVANTEST[®]

第2期中期経営計画（FY21-FY23）の初年度進捗

	第1期中期経営計画 実績 FY18-20平均	第2期中期経営計画 目標 FY21-23平均	FY21 実績
売上高	2,904億円	3,500~3,800億円	4,169億円
営業利益率	22.3%	23~25%	27.5%
当期利益	601億円	620~700億円	873億円
ROE	29.1%	20%以上	30.4%
1株当たり当期利益 (EPS)	309円	320~370円	450円

<成長投資>

	FY21-23 投資枠	FY21 実績
M&A等戦略投資	1,000億円	290億円
設備投資	400億円	180億円

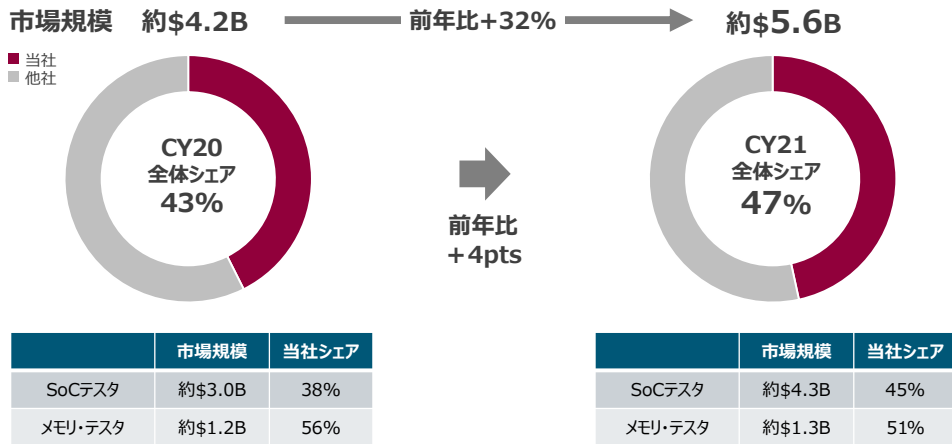
<株主還元>

	FY21-23想定	FY21 実績
株主還元額 (配当額+自己株式取得)	1,500億円以上	930億円

○ 第2期中期経営計画の初年度進捗

- 第2期中期経営計画における初年度の業績は、中計期間平均として設定したすべての経営指標の目標数値を上回る、幸先の良いスタートとなりました。
- 当社が優位性を持つスマートフォン関連、HPC関連のテスト需要の拡大に加えて、車載・産機・民生向けでも、過去から地道に進めてきた顧客基盤強化策と、製品戦略が功を奏し、関連する売上を広範囲に伸ばすことができました。
- また、M&A活用等で強化を進めているSLT部門も順調に拡大し業績向上に貢献しました。
- その結果、グランドデザインで掲げた4,000億円の売上目標を、当初企図していた2027年度を待たずに早期達成することができました。グランドデザインで描いたトレンド、ビジネス環境の大きな流れは変わらず、戦略についても継続していきますが、この売上高目標達成を機に、さらなる企業価値向上を目指していきます。
- 第2期中期経営計画については、2021年度実績、2022年度見通しを踏まえ、財務モデルの見直しを行います。こちらについては、決まり次第、説明の機会を設ける予定です。

市場シェアの状況



Source: Advantest

○ 当社の市場シェアの状況

- 暦年ベースの2021年のテスト市場の対前年成長率はプラス30%を超え、2020年の25%を上回る成長となりました。精査の結果、SoCテストは約43億米ドル、メモリ・テストは約13億米ドル、合計約56億米ドルの規模と、期初の想定をかなり上回る結果となりました。
- マーケットシェアは、47%程度と、拡大する市場の中で前年から4ポイントほど伸ばすことができました。SoCテストではおよそ45%、メモリ・テストではおよそ51%とそれぞれ首位を獲得できたのではないかと見ています。

半導体テスト市場の動向 <22年4月時点の見方>

CY21実績

- SoCテスト市場: 車載・産機・民生向けの需要拡大と、ハイエンドSoCの高性能化と生産増が牽引し、前年比約43%拡大
- メモリ・テスト市場: メモリでも大容量化の進展、高速化、高性能化が堅調に進展し、市場規模拡大

CY22予想

- SoCテスト市場: HPC*などの先端プロセス品の堅調な成長に加えて、車載・産機・民生向けも一段の伸びを予想
- メモリ・テスト市場: 大容量化や高速化、広帯域化といったメモリの高性能化が引き続きテスト需要の拡大を促進

Source: Advantest

	CY20実績	CY21実績	CY22推定
SoCテスト市場	約\$3.0B	約\$4.3B (1月時点推定:約\$4.1B)	約\$4.2-5.0B (1月時点推定: 約\$4.5B - 5.0B)
メモリ・テスト市場	約\$1.2B	約\$1.3B (1月時点推定:約\$1.3B)	約\$1.3-1.4B (1月時点推定: 約\$1.4B - 1.5B)

*HPC: ハイパフォーマンス・コンピューティング

○ 暦年2022年のテスト市場の見方

- 2022年のテスト市場も、2021年の高水準な市場規模からさらなる伸びを見込んでいます。3か月前と比べてレンジ予想の下限を少し広げたのは、部材調達環境の厳しさが増していることから業界全体での供給リスクシナリオを織り込んだものです。
- SoCテスト市場では、先端プロセスの採用が進むHPC関連での半導体高性能化と生産増を主軸に、車載・産機・民生向けでも一段の伸びを見込みます。
- メモリ・テスト市場は、為替変動の影響で、市場規模の数値的な伸びが縮小しているように見えますが、実態としては、メモリの高性能化がテスト市場の拡大を促す見方は3か月前と変わりません。
- 2023年以降のテスト市場については、流動的な要素が多く、ビジビリティが低い状態です。しかしながら、社会のエネルギー効率向上の要請を背景に、微細化と先端パッケージ採用による半導体集積度の一層の向上がHPC関連で着実に進展しています。より高度で統合されたテスト・ソリューションが求められる結果、テスト市場の拡大を長期的に促すものと見込んでいます。

開示項目の見直しについて

- 開示項目の見直し

受注高に関する開示については、2021年度をもって終了することといたします

- 見直しの背景

- ✓ 製品のリードタイム長期化により、直近の受注高実績は過去との比較参照性が低下
- ✓ 短期変動が大きい受注高情報は中長期の事業成長トレンドとは合致せず企業価値評価での有用性が低下

**受注高の開示に代わり、事業環境や成長戦略など中長期の企業価値評価に有用な情報を
充実させることで市場との対話を深めるよう取り組みます**

○ 開示項目の見直しについて

- 当社は、受注高に関する開示については2021年度をもって終了することといたします。
- 長らく、業績の先行指標として受注高開示を行ってまいりましたが、直近の受注高実績は、過去との比較参照性が低下している状態となっており、このまま受注高開示を継続することは、市場関係者の皆様へミスリーディングな情報をもたらすものと懸念しています。
- 今後はより中長期の時間軸をもった事業環境や成長戦略の説明を充実させ、株式市場の皆様が適正に企業価値を判断できるよう対話を深めたいと考えておりますのでご理解をお願いいたします。

FY22業績予想

(億円)

	FY21 実績	FY22 予想	前年度比	
			増減額	増減率
			売上高*1	4,169
営業利益	1,147	1,500	+353	+30.7%
営業利益率	27.5%	29.4%	+1.9pts	
税引前利益	1,163	1,500	+337	+28.9%
当期利益	873	1,125	+252	+28.9%
当期利益率	20.9%	22.1%	+1.2pts	
研究開発費	484	600	+116	+24.0%
設備投資	180	270	+90	+50.0%
減価償却費	150	168	+18	+12.0%
為替レート*2	1米ドル	112円	120円	8円 円安
	1ユーロ	130円	135円	5円 円安

*1: 合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

*2: 為替レート変動が今後の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+13億円です。対ユーロは-2億円です

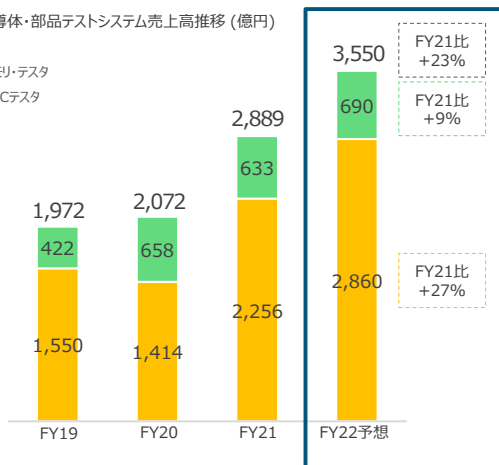
○ 2022年度の業績予想

- 2022年度は、売上高5,100億円、営業利益1,500億円、税引前利益1,500億円、当期利益1,125億円と予想しています。
- 通期の売上総利益率は、58%程度を想定しています。
- 部材調達は非常に厳しい状況が続いています。業績予想では部材不足並びに調達コストの上昇を一定程度織り込んでいますが、下期には部材不足の改善を想定しています。部材の確保に最大限取り組み、売上、利益ともに3年連続の年度最高記録更新をめざします。
- しかしながら部材調達面の不調のみならず、地政学的リスクや世界経済の変調など突発的な事象が発生することは十分あり得る環境であることは間違いなく、リスク対応力が一層問われる一年であると考えております。
- 予想の前提とした為替レートは、米ドルが120円、ユーロが135円です。

FY22見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム売上高推移（億円）

■ メモリ・テスト
■ SoCテスト



半導体・部品テストシステム事業

<SoCテスト>

一段の微細化がテスト時間を伸ばすトレンドにある中、FY22は、先端プロセスを採用するHPCデバイスの品種数・生産量が増加。さらなるテスト需要を喚起

アプリケーション別内訳	FY19	FY20	FY21	FY22(予)
コンピューティング・通信	70%	55%	60%	70%
車載・産業機器・民生・DDIC*	30%	45%	40%	30%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

<メモリ・テスト>

DRAMの微細化進展を受けての大容量化対応需要、DRAM高速化/広帯域化対応需要などで底堅く拡大

アプリケーション別内訳	FY19	FY20	FY21	FY22(予)
DRAM	70%	60%	60%	60%
NVM	30%	40%	40%	40%

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

21 | ADVANTEST

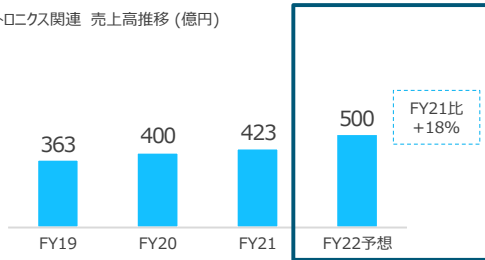
*DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC
All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- ・ スライド右側の通り、今回よりアプリケーション別の通期売上の開示をはじめます。
- ・ SoCテストの2022年度通期売上予想を、2,860億円とします。
- ・ 先端SoC半導体では、CY22も先端プロセスの採用がいっそう進みます。半導体の複雑化や製造難易度の上昇がテスト需要を押し上げる局面が、年間を通じて継続する見込みです。過去10年間、スマートフォンのAPUがテスト需要の主軸でしたが、CY22はHPCが主軸になると想定しています。
- ・ 車載・産機・民生セグメントでも、顧客の稼働率も高い水準が継続し、FY21同等のテスト需要が見込まれます。
- ・ メモリテストの2022年度通期売上予想は、690億円とします。
- ・ メモリの微細化、大容量化、高速化/広帯域化といったメモリの技術変化に伴うテスト需要が継続しています。
- ・ データセンター向けのHPCの需要が旺盛な状況に呼応し、NANDやDDR4/5の需要は安定的に推移するものと見込んでいます。中でも当社が強みをもつDRAM向けの売上の拡大を見込みます。

FY22見通し（事業別）

メカトロニクス関連 売上高推移（億円）

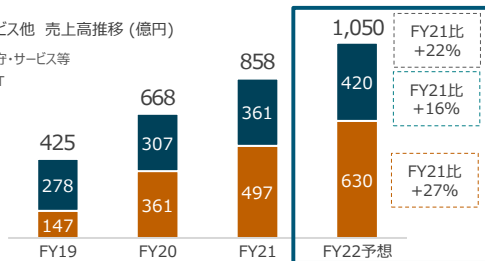


メカトロニクス関連事業

- テスタ需要と連動し、高水準なデバイス・インタフェース製品の需要も期待
- EUV露光の普及を受け、ナノテクノロジー製品の販売も順調

サービス他 売上高推移（億円）

■ 保守・サービス等
■ SLT



サービス他事業

- システムレベルテスト事業の堅調な伸びと、過年度成長投資を行ったリカーリングビジネスの売上増を見込む
- 当社製品の設置台数の着実な伸びと、顧客における高い稼働率を背景に、保守サービスの需要増も順調

○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- ・ メカトロニクス関連事業の、2022年度通期売上予想は500億円とします。テスタ事業と連動し、高水準なデバイス・インタフェース製品の需要継続と、EUV露光の普及を受け、ナノテクノロジー製品の販売増を見込みます。
- ・ サービス他事業については、2022年度通期売上予想を1,050億円とします。システムレベルテスト事業の堅調な伸びと、M&Aで強化したリカーリングビジネスの売上増に加えて、サービス保守事業の底堅い需要増を見込んでいます。
- ・ なおシステムレベルテスト事業についても、今回より通期の売上金額を開示しております。

FY22の主要施策

- 部材調達難の長期化に対し、製品安定供給のための施策を最優先
- 最先端の半導体技術開発に取り組む顧客と協業し、高度な試験技術を開発
- 一段の業容拡大に向け、中長期視点で人材・設備の増強を図ることで事業基盤を強化
- デジタル・トランスフォーメーションを当社の成長機会とするため、データ・アナリティクス分野の取り組みを強化
- 半導体テスト工程に加えSLT需要も堅調に伸長。テスト本体にとどまらず、消耗品などリカーリングビジネスも強化
- 気候変動対応をはじめとし、ESGのさらなる推進を継続
- 地政学的リスクの高まり、インフレ進行など事業環境における不確実性が高い中、環境の変化に機動的に対応

○ 2022年度の主要施策

- 今年度の施策について少し触れて、締めくくりとさせていただきます。
- 半導体を中心に部材調達難の長期化が続いています。当社製品の安定供給に向けた施策実行を最優先します。
- 2022年も半導体テスト市場の成長が見込まれます。最先端のテストソリューションを提供し続けることをR&Dおよび営業活動の重点施策とします。最先端の半導体技術開発に取り組む顧客と協業し、高度な試験技術を開発していきます。
- また、テスト市場は中長期的にもさらなる拡大が見込まれます。当社の事業遂行能力を一段と引き上げる必要があります。有能人材の確保や設備の増強など先行投資となることを恐れず実施していく予定です。
- 特にデジタル社会におけるビジネス変革を見据えて、データ・アナリティクスビジネスの強化を進める予定です。
- 回路集積度の向上や製造難易度の高まりが、デバイスの信頼性要求を高めています。半導体テストの需要に加え、システムレベルテストを採用する動きも堅調に伸びを示しています。それに呼応し、テストプロセス全体にわたって高精度な消耗品の需要も増加します。リカーリングビジネスの拡大のために投資を進めます。
- SBTi認定取得など、前年度は気候変動対応で進捗があったESG関連についても、一層の高度化に取り組みます。2021年度の成果は当社WEBでのリリースをご覧ください。
- 最後に、地政学リスクの高まり、物流混乱、インフレ進行など事業環境における不確実性が高い中、環境の変化に機動的に対応してまいります。
- 私からは以上です。本日はありがとうございました。